



2023年8月8日

各 位

会 社 名 住友大阪セメント株式会社
代 表 者 名 取締役社長 諸橋 央典
(コード番号：5323、東証プライム市場)
問 合 せ 先 企画部長 今井 知足
(TEL. 03-6370-2725)

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2023年5月30日開催の取締役会において、2020年8月26日に導入した当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）および執行役員（以下総称して「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」といいます。）を継続することを決議しております。また、当社は、本日開催の取締役会において、本制度について本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2020年5月22日付「取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(8) 信託契約日	2020年8月26日
(9) 金銭を追加信託する日	2023年8月24日（予定）
(10) 信託終了日（継続後）	2026年8月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得資金として当社が信託する金額	51,207,000円
(3) 取得する株式の総数	13,000株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得
(5) 株式の取得時期	2023年8月24日（予定）

以 上